

Wafer Bonding Machine

サファイア、SiC、GaN などの ウェハ・基板をセラミックやガラスなどの支持基板（貼付け板）にワックスで接着させる貼付装置のご案内です。

四つの特徴

貼付け時の真空・脱泡

ワックスに含まれる気泡や、反ったウェハーを貼付ける時に残ってしまう空気など、真空状態で貼付けるため脱泡効果が期待できます。

エアバッグによる加圧

ダイヤフラム様式によってワークを均等に加圧するため、支持基板にムラなく均一に貼付けることが可能です。

プログラムコントロール

ワークを貼付ける一連の作業をシーケンサーと温度コントローラーにて制御しているため、条件を設定すればセミオート化が可能です。

間接水冷却で収縮防止

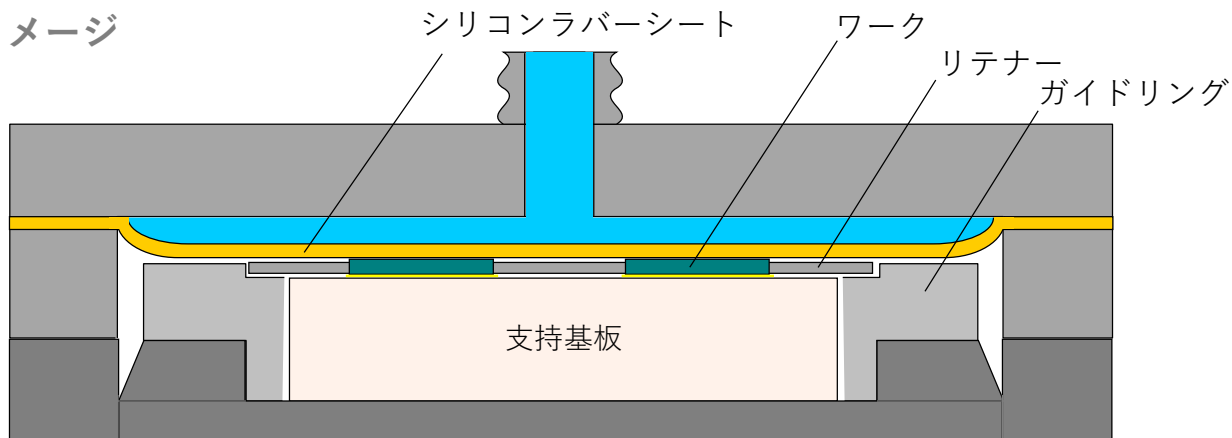
ワックスの硬化時間（冷却時間）を設定することが出来るため、急速冷却によるワックスの収縮を防ぐことが可能です。

装置仕様

- ◇ウェハサイズ : 3~6インチ
- ◇支持板 : ~φ190mm
- ◇設定温度範囲 : 室温~140°C
- ◇圧力設定範囲 : 0.05~0.3MPa
- ◇ユーティリティ : 入力電源 AC200V 1PH 50/60Hz
消費電力 35A
供給気体圧力 クリーンドライエアー 0.4~0.5MPa 700L/min(ANR)
- ◇装置本体寸法 : W830mm × D800mm × H1582mm
- ◇重量 : 約280kg



加圧イメージ



ケメットジャパン株式会社

Kemet

〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目13番6号 KJビル5階
TEL : 03-6417-4929 FAX : 03-6417-4839 INFO : info@kemet.jp